

Con un 47% más de visitantes pre-registrados

## **EASYFAIRS® EMPACK 2010 SE CONSOLIDA COMO CITA DE REFERENCIA PARA LA INDUSTRIA DEL ENVASE Y EL EMBALAJE**

- *IFEMA, Feria de Madrid, acogerá los días 24 y 25 de noviembre la tercera edición de EMPACK 2010, con las últimas soluciones en envase, embalaje, almacenamiento y acondicionamiento.*
- *La intralogística y el packaging farmacéutico serán las principales novedades de este año.*
- *Los seminarios gratuitos contarán el apoyo y la participación de ITENE, FARMAESPAÑA, AIMPLAS y PACKNET.*

La tercera edición de easyFairs® EMPACK 2010, el Salón Profesional del envase, embalaje, almacenamiento y acondicionamiento, abrirá sus puertas los días **24 y 25 de noviembre** en el Pabellón 2 de IFEMA- Feria de Madrid.

**Más de 100 expositores** presentarán sus novedades en soluciones y maquinaria de envasado y embalaje, reciclaje, etiquetado, codificación, trazabilidad y RFID, materiales, PLV y embalaje publicitario. Además, y como novedad respecto a ediciones anteriores, EMPACK 2010 dedicará un espacio destacado a la **intralogística y al envasado farmacéutico**. [Listado de expositores](#).

Según la organización, el significativo **aumento en la cifra de visitantes pre-registrados, un 47% más** que en las mismas fechas del año anterior, denota el interés creciente de las empresas por optimizar sus procesos de envasado y embalaje, maximizar la calidad y vida útil de sus productos, mejorar su protección durante el transporte y reducir sus costes. En total, se espera que sean más de **3.800 los visitantes** profesionales que acudan al Salón.

Por otra parte, la formación gratuita impartida durante la celebración del Salón, a través de los seminarios learnShops, brindará la oportunidad a los visitantes de profundizar en diferentes temáticas.

En este sentido, EMPACK 2010 incluirá seminarios específicos sobre el **Packaging & Intralogística**, organizado junto con **ITENE** (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística), el **Packaging farmacéutico**, organizado junto con la revista **Farmespaña Industrial**, y el **Análisis de riesgos en el envasado y distribución de bienes industriales y de consumo**, organizado conjuntamente con **AIMPLAS**, Instituto Tecnológico del Plástico.

Además **PACKNET**, la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje, presentará la Mesa Redonda: **Una apuesta por la innovación en envase y embalaje**. [Consulte programa completo de conferencias](#)

La entrada es exclusiva para profesionales. Registro gratuito on-line. [CÓDIGO I23997](#)

**easyFairs** es uno de los líderes globales en la organización de salones profesionales que permiten a las empresas optimizar presupuesto, tiempo y recursos. Facilita que expositores y visitantes motivados puedan hacer negocios cara a cara en un entorno focalizado y profesional. Con sede central en Bruselas, easyFairs organiza más de 100 salones especializados en 8 sectores de negocio en Alemania, Austria, Bélgica, Colombia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza. easyFairs lleva cada salón al corazón de los mercados.

#### Más información y fotos

**Lorena Albella**

Marketing Coordinator

E-mail: [lorena.albella@easyfairs.com](mailto:lorena.albella@easyfairs.com)

Tel: +34 91 559 10 37

**Laura Gutiérrez- Dosal Manso**

Media Relations Officer

E-mail: [laura.gutierrez-dosal.manso@easyfairs.com](mailto:laura.gutierrez-dosal.manso@easyfairs.com)[www.easyfairs.com/empackmad](http://www.easyfairs.com/empackmad)